



경 기 도



수신 수신자 참조

(경유)

제 목 「2023 차세대 반도체 패키징 장비·재료 산업전」(8.30.~9.1.) 개최 알림 및 참가 협조 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 도내 반도체 기업 지원을 위하여, 경기도는 「2023 차세대 반도체 패키징 장비·재료 산업전」을 수원시와 공동으로 아래와 같이 개최할 예정임을 알려드리니 많은 참여를 부탁드립니다. 관심있는 기관, 단체 및 기업 등이 참여할 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 행사개요

- 가. 행 사 명 : 2023 차세대 반도체 패키징 장비·재료 산업전(ASPS)
- 나. 기 간 : 2023. 8. 30.(수) ~ 9.1.(금) (3일 간)
- 다. 장 소 : 수원컨벤션센터 전시홀(7,877m²), 컨벤션홀 등
- 라. 주최/주관 : 경기도·수원시(공동주최) / (재)수원컨벤션센터, (주)제이엑스포·전자신문
- 마. 전시품목 : 반도체 패키징 검사·어셈블리·본딩 장비, 테스트 장비 및 솔루션, 부품 재료, 코팅장비, 절단·접착·세척·드릴링 장비, 반도체 PCB, 후공정 장비 및 소재
- 바. 행사구성 : 반도체 패키징 전시회, 전문 컨퍼런스, 기술세미나, 수출상담회 등

붙임 행사 안내자료 1부. 끝.

경 기 도 자 사

수신자 시군 반도체 관련 부서(30), 반도체 관련 유관기관(17), 반도체 관련 대학(22)



주무관

백종기

반도체 육성팀

장

이영수

반도체 산업과 전결 2023. 8. 24.

장

송은실

협조자

시행 반도체산업과-6470

(2023. 8. 24.)

접수

우 16508 경기도 수원시 영통구 도청로 30, 23층 반도체산업과

/ <http://www.gg.go.kr/>

전화번호 031-8008-6077

팩스번호 031-8008-6089

/ endymask77@gg.go.kr

/ 대국민 공개

행복한 일자리 경기도가 만들어 갑니다